

パワー半導体用基板製造子会社 を増資 フェローテックHD

フェローテックホールディングス(東京都中央区)は、パワー半導体用基板製造子会社の江蘇富楽徳半導体科技(FTSJ)が第三者割当増資を行うことを決定した。

サーモモジュールを応用したパワー半導体用絶縁・放熱基板(DCB基板)は、エアコンのインバーターなどの白物家電、ロボット、NC(数値制御)加工機械、サーボ、インバーター、自動車のエンジンやモーター、パワーステアリング、ヘッドランプなどの制御装置の基板として採用されている。DCB基板の材質は、アルミナセラミックスとなる。

また、同基板は自然エネルギー(風力発電・太陽光発電など)関連装置のモーター制御用インバーター向けとしても用いられている。

フェローテックホールディングスは、子会社の上海中和熱磁電子(FTS)でDCB基板の生産を開始し、2018年に中国・江蘇省にFTSJを新設して生産能力を拡充した。現在、月産60万枚のDCB基板のマスターカードの生産体制を構築している。2019年からは、HEVやEV車の販売台数増加に伴うインバーターやコンバーターのパワーモジュール向けに、窒化ケイ素や窒化アルミニウムを基材としたAMB(活性ロウ付け法)方式の新技术による基板を開発し、

現在は本格量産に向けた準備を行っている。

中国のパワー半導体市場は拡大しており、同社は業容拡大のため、将来的な顧客の需要増加に合わせた設備投資や自動化投資、新素材の開発などへの対応を進める。そうした中、将来的にFTSJを中国のハイテク企業向け市場である科创板市場へ上場させることを前提に、地元政府基金や主要顧客との戦略パートナー関係を構築することが企業価値向上に資すると判断し、第三者割当増資を行うことを決定した。